

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：台灣發明協會

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：東海大學

發文日期：中華民國113年5月8日

發文字號：台發協字第字第1130000002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：美國矽谷國際發明展簡章 (0000002A00_ATTCH1.pdf)

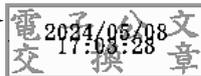
主旨：本會籌組『2024美國矽谷國際發明展』，懇請貴單位轉知所屬。

說明：

- 一、一、請查照，本會籌組之「美國矽谷國際發明展-台灣參展團」，多年來展出之成績優異，獲獎甚多，拓展之商機，每年俱增，為使更多發明人知悉此展訊，懇請貴單位轉知所屬及各大專院校與各高級中小學。
- 二、二、2024美國矽谷國際發明展，展期為7月26日~7月28日為期3天，假聖克拉拉會議中心舉行展出，每年有來自美國、英國、法國、德國、泰國及伊朗…等多個國家參賽，請代為轉發至各級學校。
- 三、附件：美國矽谷國際發明展簡章

正本：發明展大專院校二

副本：台灣發明協會、中華台北著作權人協會



東海大學

